DECC สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ “ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วย Engineering Design” ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2013

DECC สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ **“ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วย Engineering Design”** ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2013 จัดโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช.

<u>กำหนดการสัมมนา</u>

“ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วย Engineering Design”

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR 220

จัดโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.45 น. บรรยายหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี CAE”

โดยวิทยากร รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส DECC , สวทช.

14.45 – 15.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

ในการประยุกต์ใช้ CAE เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ

คุณเอกลักษณ์ ปุกปะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อัมพร ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปียา รักษาการผู้อำนวยการ DECC สวทช.

15.30 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนของภาครัฐกับการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย”

- *ตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวคุณ*
- *หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากITAP*
- *ทิศทางการให้บริการ และการสนับสนุนผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2556*

โดยวิทยากร คุณนันทิยา วิริยบัณฑร ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) สวทช.